(19)日本国特許庁(JP) (12) **公開特許公報**(A) (11)特許出願公開番号

特開2002 - 202514

(P2002 - 202514A)

(43)公開日 平成14年7月19日(2002.7.19)

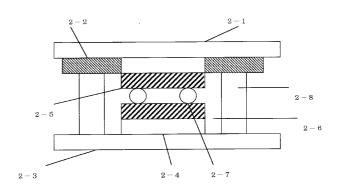
(51) Int .CI ⁷		FI	テーマコード(参考)
G 0 2 F	1/1339 505	G 0 2 F 1/1339	505 2 H 0 8 9
	1/1335 500	1/1335	500 2 H 0 9 1
	1/1341	1/1341	5 G 4 3 5
G 0 9 F	9/00 338	G 0 9 F 9/00	338
	343		343 Z
		審査請求 有	請求項の数 40 L (全 6 数)
(21)出願番号	特願2000 - 400379(P2000 - 400379)	(71)出願人 000005821	·
		松下電器産	E業株式会社
(22)出願日	平成12年12月28日(2000.12.28)	大阪府門真	東市大字門真1006番地
		(72)発明者 山田 聡	
			東市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会	会社内
		(72)発明者 山田 佳照	3
		大阪府門真	東市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会	会社内
		(74)代理人 100097445	
		弁理士 岩	岩橋 文雄 (外2名)
			, , ,
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶パネルおよびその製造方法およびその製造装置

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 カラー反射型液晶パネルにおけるシール材の 紫外線硬化を容易にする。

【解決手段】 対向する2枚の基板2-1,2-3を接 着し、液晶2-6を封入するための紫外線硬化型シール 材2-8を形成する工程と、シール材2-8を形成した 基板と対向する基板の位置合わせを行ったあと2枚の基 板を貼り合わせる工程と、所定のギャップとなるように 貼り合わせた基板を加圧する工程と、シール部分以外を 遮光し、基板の温度を40 以上80 以下の温度範囲 内で調整しシール部分に紫外線を照射する工程と、必要 な端子部分を残して割断し液晶セルを作成する工程とを 有することを特徴とする液晶パネルの製造方法。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 少なくとも一方の基板の電極が遮光性の ある材質で形成されていて、他方の基板はカラーフィル ターと、ブラックマトリクスとが形成されている液晶パ ネルの製造方法であって、前記一方の基板には、2枚の 基板を接着し、液晶を封入するための紫外線硬化型シー ル材を形成する工程と、前記シール材を形成した基板と 対向する基板の位置合わせを行ったあと2枚の基板を貼 り合わせる工程と、所定のギャップとなるように前記貼 り合わせた基板を加圧する工程と、シール部分以外を遮 10 優れているが、光開始剤にカチオン系のイオン性の高い 光し、基板の温度を40 以上80 以下の温度範囲内 で調整しシール部分に紫外線を照射する工程と、必要な 端子部分を残して割断し液晶セルを作成する工程とを有 することを特徴とする液晶パネルの製造方法。

【請求項2】 請求項1に記載の液晶パネルの製造方法 であって、前記シール材を形成する工程と、前記2枚の 基板を貼り合わせる工程との間に、液晶を滴下供給する 工程を含むことを特徴とする液晶パネルの製造方法。

【請求項3】 前記紫外線硬化型のシール材が、メタク リルまたはアクリル性の樹脂で構成されており、光開始 20 剤の成分がアセトフェノン系、ベンゾイン系、またはベ ンゾフェノン系のいずれかであり、その配合比が1wt %以上3wt%以下で、光開始助剤としてチオキサンソ ン系でその配合比が 1 w t %以上3w t %以下であるこ とを特徴とする請求項1、または2のいずれかに記載の 液晶パネルの製造方法。

【請求項4】 前記シールに照射する紫外線の有効波長 領域は310nm以上400nm以下であり、前記波長 領域での照度が10mw/cm²、30mw/cm²以下 で、積算光量が3000mJ/cm²以上10000m 30 J/cm²であることを特徴とする請求項1から3のい ずれかに記載の液晶パネルの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶パネルの製造 方法に関する。

[0002]

【従来の技術】2枚の電極付き基板の間隙に液晶を封入 してなる液晶パネルの製造方法に関しては2枚の基板を 接着し、液晶を封入する目的で使用されているシール材 40 には1液タイプの熱硬化型エポキシ樹脂(三井東圧化学 工業製 " ストラクトボンド X N - 2 1 - S " 、協立化学 産業株式会社製 "ワールドロック 7 8 0 - B - B "がよ く知られている。

【0003】この熱硬化型エポキシ樹脂を成分とするシ ール材は、基盤を貼り合せた後に行う熱硬化の工程で、 過熱の初期の段階でシール材のシール材の粘度が低下す ることから基板の位置合わせ精度の低下、シールの線切 れ、シールの浮き上がりによるギャップ不良といった課 題が発生する。また、熱硬化には1時間程度必要なこと 50 途の多様化に伴い、周辺部の狭額縁化が通常化してい

から生産効率の低下、、さらにはマザー基板の大型化に 伴い熱硬化設備の大型化が発生する。

【0004】こうした課題を解決するにあたり紫外線硬 化型のシール材を採用する方法が考えられる。紫外線硬 化型シール材に関しては、一般的にカチオン重合とラジ カル重合の2種類がある。前者のカチオン重合はエポキ シ樹脂の硬化機構であり、ラジカル重合はメタクリル、 あるいはアクリル樹脂の硬化機構である。ここでカチオ ン重合であるエポキシ樹脂は、接着性、体質性に関して ものを使用するため、液晶への信頼性が低い。従って、 カチオン重合であるエポキシ樹脂を成分とした紫外線硬 化型シール剤の使用は困難である。この紫外線硬化型エ ポキシ樹脂に対し、紫外線硬化型メタクリル、アクリル 系樹脂はラジカル重合体であり、使用する光開始剤のイ オン性が低いことから、前記滴下工法での使用も可能で ある。従って一般的に紫外線硬化型シール材としてはこ のラジカル重合体のメタクリル、アクリル樹脂を使用す

【0005】液晶パネルの製造方法に関しては、一対の 電極を形成した基板に、ポリイミド樹脂からなる配向膜 を形成し、ラビングといわれる、布で配向膜表面をこす ることにより液晶の配向方向を決定する工程を行う。こ うして配向処理を施した基板に前記紫外線硬化型シール 材を、スクリーン印刷、及びディスペンサーによる描画 塗布によって、所定のパターンとなるよう形成する。そ して他方の基板には基板間のギャップを形成するための スペーサー材を配置する。このスペーサー材は樹脂製の ビーズが主に使用されているが、最近では基板上に樹脂 製の柱を形成したものも使用されている。この2枚の基 板の位置合わせを行い貼り合せ、2枚の基板間が所定の ギャップとなるまで加圧する。その後、シール部分以外 の領域を遮光してシール部分のみ紫外線を照射しシール の硬化を行う。そして貼り合せし接着した2枚の基板の 中で不必要な部分を割断し液晶セルを作成する。なお、 基板を貼り合せる前に液晶材料をシール材で囲まれた領 域内に必要量だけ滴下供給し、2枚の基板を0.8To rr以下の減圧下で位置合せを行い貼り合せる滴下工法 も液晶セルの製造方法としてはよく知られている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】これまで紫外線硬化型 のシール材を使用する場合、シール部分には紫外線が照 射されなければならない。従って、必然的に電極部はI TOのような透明電極で形成された基板、もしくは、カ ラーフィルターが形成された基板では、そのブラックマ トリクスの外周部にシールが形成されたパネルでなけれ ば不可能であった。現在では、TFTが形成された液晶 パネルが安価に製造できることから市場での要求が増加 している。また、このTFTを形成した液晶パネルも用

る。さらに、STNでも携帯用の省電力液晶パネルとし てカラーで反射型の液晶パネルの要求が増加している。 こうした液晶パネルのニーズの中で、TFT、及びST Nカラー反射型の液晶パネルでは、電極がA1で形成さ れ紫外線を完全に遮光してしまう。またカラー化と狭額 縁化に伴い、シールの形成位置はカラーフィルターのブ ラックマトリクス上となってしまう。こうした液晶パネ ル構成の中でシール材の紫外線硬化が非常に困難とな る。

ル部分に照射しシール材を硬化しなければならない。現 状でA1の電極の幅は50µmから100µm程度であ リ、電極間のスペース部分は5μmから20μm程度で ある。こうしたパターンのもと配線の影になる部分でも 十分シール材の重合が行われるための紫外線照射条件、 及びシール材料が必要となる。

【0008】本発明は、基板の貼り合せ精度、及び生産 性の向上を図ることが可能な紫外線硬化型のシール材を 使用する液晶パネルの製造方法に関し、狭額縁化した力 ラーTFT液晶パネルや反射型カラーSTNパネルに対 20 だ滴下工法を採用した場合、シール材への紫外線照射時 応できる液晶パネルの製造方法を提供することを目的と する。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するにあ たり、本発明の液晶パネルの製造方法の中で,特にシー ル材の紫外線硬化工程に関して、紫外線を照射する際の 基板の温度を調整することにより達成できる。このとき 基板の温度は40 以上80 以下で適宜選択する。通 常紫外線照射時の基板温度が高いほどシールの重合は促 進される。しかし滴下工法を採用する際には、紫外線照 30 射時の温度が高いと十分に硬化していないシール材から 液晶中にシール組成分の溶出による表示品位の低下、及 びギャップ高やシール切れによる歩留まりの低下が起こ る。

【0010】この場合は、基板の温度を時間とともに上 昇させるか、ステージを2段階に分割し、第1のステー ジで低温度でシールに紫外線照射を行い、第2のステー ジで高い温度で紫外線照射を行い十分にシールを硬化す る方法を採用すれば解決できる。

【0011】この紫外線照射時の基板の温度を調整する 40 0秒しかかからないことから十分所定の温度での紫外線 方法としては、ホットプレート、温風循環、紫外線吸収 によるマスク基板の温度上昇のいずれを採用してもよ い。

【0012】つぎに、上記条件のもと使用する紫外線硬 化方シール材に関して、樹脂成分にはメタクリル、アク リル系いずれかの樹脂を主材とする。主にエポキシアク リレートのオリゴマーと粘度調整用のモノマーを適宜配 合した成分を使用することが望ましい。この主材に対し て光開始剤を1wt%から3wt%の範囲内で適宜配合 する。また、光開始剤としてチオキサンソン系のものを 50 のシール材が紫外線硬化型で、このシール材を紫外線照

1 w t % から 3 w t % の範囲内で適宜配合する。ここで 光開始剤としては、アセトフェノン系、ベンゾイン系、 ベンゾフェノン系のいずれかから選択すればよいが、特 にベンゾイン系の光開始剤が望ましい。なお、シール材 に関しては粘度調整用としてフィラー材、基板との密着 性向上のためにシラン系カップリング材を適宜配合する ことが望ましい。

【0013】本発明による液晶パネルの製造方法に関し て、紫外線硬化型のメタクリル、アクリル系シール材の 【0007】この場合、A1の電極側から紫外線をシー 10 紫外線照射工程で、紫外線照射時の基板の温度を調整す ることにより、狭額縁設計のTFT液晶パネル、反射型 カラーSTNパネルといった電極成分がAlのような遮 光される材質で形成された液晶パネルでもシール材の紫 外線硬化が可能であり、今後のパネル設計に大きな負担 をかけることなく液晶パネルの生産が可能となる。

> 【0014】ここでシール材への紫外線照射時の基板温 度は、40 から80 の範囲で任意に選択すればよ い。通常シール材の紫外線硬化のみであれば基板の温度 を高く設定すればよりシール材の硬化は促進される。た の基板温度が80 を超えると、液晶の相転移温度以上 となり、液晶が等方相となりシール材成分の溶解性が高 くなる。また液晶の体積も増加することからシール材の 高さも変化する。よって紫外線照射時の基板の温度は8 0度以下が望ましい。

> 【0015】また、シール硬化に使用する紫外線は31 0 n m以下の波長をカットする必要性がある。これは紫 外線による液晶へのダメージを防止するためである。従 ってシール硬化に使用する紫外線としては、波長領域が 310 n m 以上 400 n m 以下で、照度が 10 m w / c m²以上で、積算光量として3000mJ/cm²以上が 必要となる。この条件範囲の中で照度が最も大きい30 mw/cm²で積算光量3000mJ/cm²を達成す る場合照射時間が100秒となる。このとき設定した基 板温度のキープ時間は100秒から基板が上昇するまで の時間を引き算した時間となる。基板の面積が約250 000mm²から約64000mm²で、基板の厚みが 約1mmから約0.5mmのとき、この基板を2枚重ね て基板の温度が80 まで達するのに約10秒から約2 照射が可能である。

> 【0016】以上、本発明によるシール材の紫外線硬化 方法によりアライメント精度が高く、電極部が遮光され た場合でもシール材の十分な硬化が可能になることか ら、表示品位の高い液晶パネルを生産できる液晶パネル の製造方法を提供できる。

[0017]

【実施の形態】本発明の液晶パネルの製造方法に関し て、液晶を封入するとともに2枚の基板を接着するため

射すると同時に加熱することが特徴である。

【0018】ここで使用した紫外線硬化型シール材の組 成に関して説明すると、主材としてエポキシアクリレー トオリゴマーと3官能アクリレートモノマー、フィラー 材にタルクとシリカ系微粉末、シランカップリング剤、 光開始剤としてベンゾイン系を1から3wt%配合した ものを使用した。

【0019】基板は、面積が約25000mm²から 約64000mm2で、基板の厚みが約1mmから約 0.5mmの形状の範囲であればよいが、本実施例で は、基板の寸法が、550mm×670mmで、基板の 厚みが0.7mmである。

【0020】次に上記シール剤を硬化するための紫外線 照射方法を図面を用いて説明する。

【0021】図1は今回採用した紫外線照射装置の概略 図で、ランプ1-1は高圧水銀ランプを使用し、310 nm以下をカットするガラス1 - 2を挿入することによ リカットした。そして、ランプの波長領域が310nm から400nmの範囲での照度が10から13mw/c m²となるように設定した。そして照射時間を10分、 つまり照射エネルギーとして6000から7800mJ cm²とした。さらにシール部分以外には紫外線が照射 されないようマスク1-3をランプ1と基板1-4の間 にクリラランスが1mmとなるよう挿入した。使用する マスク1-3の材質はテンパックスガラスで紫外線領域 の照度ロスは殆どない。そして基板の下には温度を調節 するためのホットプレート1 - 5を設置した。

[0022]

【実施例】以下、本発明の具体的な実施例と比較例を図 面を用いて説明する。

【0023】まず図2にて今回作成した液晶パネルの断 面図を示す。一対の基板のうち、上野紫外線照射される 側の基板 2 - 1 には、スリット状に多層 C r 層 2 - 2 が 設けられている。なお、下の基板2-3にはこの多層C r 2 - 2 は形成していない。このスリットのパターンは 遮光部分が40μmと50μmの2種類、スペース部分 が 5 μm、 1 0 μm、 2 0 μmの 3 種類合計 6 種類のパ ターンを準備した。そして上下の基板に対向するように ITOによる透明電極2-4を設置する。そしてこの電 極上のポリイミド性の配向膜2 - 5を形成する。そして 40 射時の温度に対しては、スペース部分のシール材の重合 この配向膜2-5はラビングによって液晶2-6のネジ レ角度が90度となるように配向処理が施されている。 さらに2枚の基板のギャップを形成するためのスペーサ ー用の樹脂ビーズ2 - 7が配置されている。今回このビ ーズ2 - 7 は粒径が4 . 5 μ m で密度が100個 / m m ²となるように配置した。そして液晶2-6を封入し2 枚の基板を接着するためのアクリル系の紫外線硬化型シ ール材2-8が多層Crの下部に設置されている。

【0024】次に、前記液晶パネルの評価結果を1に示 す。評価項目としてはシール材の配向異常の幅と5 Vで 50 8 0 で照射時間が2 0 0 秒、実施例7 として8 0 で

30Hzのパルス波を液晶に印加したときの液晶の電圧 保持を表す電圧保持率を採用した。

【0025】まず従来例1としてエポキシ系の熱硬化型 シール材(三井東圧化学工業株式会社製"ストラクトボ ンドXN-21-S"を使用した。さらに比較例1とし て前記アクリル系紫外線硬化型シール材を用いて、紫外 線照射時の基板の温度が25 、実施例1として基板の 温度が40、実施例2として60、実施例3として 80度の場合の結果を示す。なお、基板はホットプレー 10 トの温度を目的の温度に設定しその上にそのまま置い た。従って基板は40 には約5秒、60 には約10 秒、80 には約15秒で達する。ここで所定の温度の 保持時間は十分同等である。

【0026】この結果から比較例1では、シール材の配 向異常の幅が0.5mm以上で電圧保持率が90%程度 と従来例に比べ程度が低い。特にシール材の配向異常の 幅に関しては、液晶パネル構成によりシールからアクテ ィブの距離が短くなっている。もし、この距離が最も短 くしても0.1mm程度となる。これはカラーフィルタ 20 一のダミーパターンが必要でありこの幅が0.1mm程 度は必要なことからである。したがってシール材の配向 異常幅は0.1mm未満が必要となる。次に保持率に関 してであるが、液晶パネルの構成により程度の差はある が、電圧保持率が90%以下となると、面内の焼き付 き、フリッカーといった表示品位に悪影響を及ぼす。従 って電圧保持率は90%以上が必要となる。また面内で の輝度むらに関しても90%以上であれば問題ない。

【0027】ここで、図3に紫外線照射時の各温度に対 する電極のスリット下のシール材重合度合いに関してラ 30 マン分光法により分析した結果を示す。このラマン分光 法での重合度合いの算出方法は、未硬化シール材の " C = C " 結合部分の吸収と紫外線照射時の温度が 8 0 で 照射エネルギーが6000mJ/cm²のときのシール 材の" C = C " 結合部分の吸収との差を 1 0 0 として、 各ポジションのシール材の" C = C " 結合部分の吸収の 割合を百分率で表した。

【0028】この結果から、配線により影となっている 部分は、スペース部分に比べシールの重合度合いは20 %程度低いが、距離には大きく依存しない。ただし、照 度合いが低下していくが、配線影とスペース部分とのシ ール材重合度合いの差は大きく影響されない。表1での 実パネル評価からこのラマン分光法の重合度合いの求め 方から60%以上であれば使用上の問題はない。

【 0 0 2 9 】次に、表 2 に紫外線ランプの照度が 3 0 m v/cm²の場合のシール材配向異常、電圧保持率の結 果を示す。ここで前記実施例3と、実施例4として基板 温度が40 で照射時間が200秒、実施例5として基 板温度が40 で照射時間が600秒、実施例6として

照射時間が600秒の場合の結果を示す。なお、比較例2として25 で照射時間が200秒、比較例3として25 で照射時間が600秒の場合を示す。ここで照射時間が200秒のとき照射エネルギーが6000mJ/cm、600秒のとき18000mJ/cm²となる。

7

【0030】この結果から基板温度が40 で200秒 の場合でも周辺の配向状態は問題ない。しかし基板温度が25 の場合は照射時間が長くなると、若干の効果が見られるが品質を満足させるだけのものではない。従って紫外線照射時の基板の温度がシール材の硬化に大きな10影響を与えている。

【0031】さらに滴下工法で液晶パネルを作成する際 に、紫外線照射時の基板温度を上昇させる場合の課題 は、シール材の硬化が不十分な状態で高温の液晶と接す ることである。従って、紫外線照射時に基板の温度を上 昇させて放置した際に液晶パネルのシール材の配向状態 と電圧保持率がどうなるかの結果を〈表3〉に示す。こ のとき、紫外線照射時の条件は、基板温度が80 で紫 外線ランプの照度が 1 0 mw / c m²、照射時間が 6 0 0秒で行った。実施例8として基板貼り合せから紫外線20 照射までの放置時間が室温で1分、実施例9として放置 時間が室温で2分、実施例10として基板温度が40 で放置時間1分、実施例11として基板温度60 で放 置時間1分、実施例12として基板温度80 放置時間 1分、比較例4として基板温度100 で放置時間1分 間を行った。実際の基板の上昇温度は80 で室温から 約15秒なので1分は十分長い時間となる。

*基板温度が80 までなら表示品位への影響はない。しかし基板温度が100 の場合、シール材での配向異常の幅が0.5mmと程度が悪い。このことは液晶材料の相転移温度が85 で、100 では液晶材料が等方相となりシール材の溶解性を高めるためと考えられる。実際の液晶材料で相転移温度が80 より低くなることはないので、滴下工法の場合でも紫外線照射時の基板の温度が80 までなら問題なくシール材の十分な硬化が得られる。

【 0 0 3 3 】以上から、電極部分の配線影がある液晶パネルでも、シール材を硬化するための紫外線条件として、基板の温度を 8 0 、照度が 1 0 ~ 3 0 mw / c m 2 、照射エネルギーが 6 0 0 0 m J / c m 2 以上であれば表示品位の良好な液晶パネルを提供できる。

【0034】その際に紫外線硬化型シール材料としては、メタクリル、及びアクリル系の樹脂を主材とし、光開始剤にアセトフェノン、ベンゾフェノン、ベンゾイン系のものを1wt%以上3wt%以下の範囲で配合し、光開始剤としてチオキサンソン系のものを1wt%以上3wt%以下の範囲で配合し、粘度調整用のフィラー材、シラン系のカップリング剤を配合したものを使用することが必要である。

【 0 0 3 5 】 また、今回の実施例の中では電極の配線幅を 5 0 μ mまで検討したが、ラマン分光法の結果から電極幅が 1 0 0 μ mの場合でも使用可能である。またスリット幅に関しては 5 μ m以上あれば問題ない。

[0036]

【0032】表3から、滴下工法でも、紫外線照射時の* 【表1】

×		従来例1	比較例1	実施例1	実施例2	実施例3
	配向異常幅	<0.1mm	>0.5mm	<0.1mm	<0.1mm	<0.1mm
	電圧保持率	> 9 5 %	>90%	> 9 5 %	> 9 5 %	>95%

[0037]

___* __*【表2】

1 482 1							
	比較例 2	比較例3	実施例3	実施例 4	実施例 5	実施例6	実施例7
配向異常幅	> 0.5mm	>0.3mm	<0.1mm	<0.1mm	<0.1mm	<0.1mm	<0.1mm
電圧保持率	>90%	> 9 3 %	> 9 5 %	>95%	> 9 5 %	> 9 5 %	> 9 5 %

[0038]

【表3】

	比較例4	実施例 8	実施例9	実施例10	実施例11	実施例12
配向異常幅	> 0.5mm	>0.1mm	<0.1mm	<0.1mm	<0.1mm	<0.1mm
電圧保持率	> 8 5 %	> 9 5 %	> 9 5 %	> 9 5 %	> 9 6 %	> 9 5 %

[0039]

【発明の効果】以上のように、本発明は、基板の貼り合せ精度、及び生産性の向上を図ることが可能な紫外線硬化型のシール材を使用すル液晶パネルの製造方法に関し、狭額縁化したカラーTFT液晶パネルや反射型カラーSTNパネルに対応できる液晶パネルの製造方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明による紫外線照射方法を示す概略図
- 【図2】本実施例で使用した液晶パネルの断面図
- 【図3】ラマン分光法での電極影部のシール材重合度合 を示すグラフ

【符号の説明】

- 1 1 高圧水銀ランプ
- 1 2 3 1 0 n m以下の波長をカットするガラス
- 50 1 3 遮光マスク

1 - 4 液晶パネル

1-5 ホットプレート

2 - 1 多層 C r スリット付き基板

2-2 多層 Cr スリット

2 - 3 基板

* 2 - 4 透明電極

2 - 5 配向膜

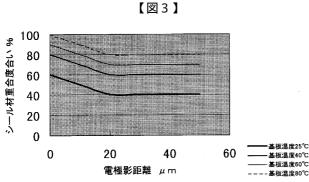
2 - 6 液晶

2 - 7 樹脂ビーズ

2-8 アクリル系紫外線硬化型シール材

【図1】 【図2】 1 – 3 1 - 42-51 – 5 2 - 42 - 72 - 3

(6)



フロントページの続き

(72)発明者 松川 秀樹 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

F ターム(参考) 2H089 MA04Y MA05Y NA22 NA24 NA37 NA44 QA12 RA10 TA01 TA09 TA12 TA13 TA17 2H091 FA02Y FA14Z FA34Y HA10 LA12 5G435 AA17 BB12 CC09 CC12 EE09 KK02 KK05 KK10



专利名称(译)	液晶面板及其制造方法和制造装置			
公开(公告)号	JP2002202514A	公开(公告)日	2002-07-19	
申请号	JP2000400379	申请日	2000-12-28	
申请(专利权)人(译)	松下电器产业有限公司			
[标]发明人	山田聡 山田佳照 松川秀樹			
发明人	山田 聡 山田 佳照 松川 秀樹			
IPC分类号	G02F1/1339 G02F1/1335 G02F1/1	341 G09F9/00		
FI分类号	G02F1/1339.505 G02F1/1335.500 G02F1/1341 G09F9/00.338 G09F9/00.343.Z G09F9/00.343			
F-TERM分类号	/FA14Z 2H091/FA34Y 2H091/HA10 5G435/EE09 5G435/KK02 5G435/I /DA89 2H189/EA04Y 2H189/EA11	TA09 2H089/TA12 2H089/TA1 D 2H091/LA12 5G435/AA17 50 KK05 5G435/KK10 2H189/DA Y 2H189/FA22 2H189/FA25 2 A15 2H189/NA05 2H191/FA0	3 2H089/TA17 2H091/FA02Y 2H091 G435/BB12 5G435/CC09 5G435/CC12 04 2H189/DA48 2H189/DA49 2H189 H189/FA53 2H189/FA54 2H189/HA12 2Y 2H191/FA13Y 2H191/FA31Z 2H191	
外部链接	<u>Espacenet</u>			

摘要(译)

(带更正)解决的问题:促进彩色反射液晶面板中密封材料的紫外线固化。解决方案:将两个彼此面对的基板2-1和2-3粘合在一起并形成用于封闭液晶2-6的紫外线固化密封剂2-8和密封剂2-8的步骤 在使面向形成的基板的基板对准之后,将两个基板粘合在一起的过程,对粘合的基板施加压力以形成预定间隙的过程以及将除密封部以外的区域遮光以保护基板。 液晶面板的特征在于包括以下步骤:在40℃以上且80℃以下的温度范围内调节温度,并向密封部照射紫外线;以及通过在留有必要的端子部的同时进行切割而形成液晶单元的步骤。 制造方法。

